

产品概述

高性能一体化制导计算机以多核处理器、高速互联和体系架构三大技术为支撑,通过嵌入式高性能密度技术,高速数据总线技术,高速模数转换接口技术,在体积、质量、功耗约束条件下,有效提高了嵌入式计算机的性能,基于多核体系结构,使其性能密度比传统单核处理系统高一个数量级。



功能及性能指标

- CPU: 采用3片TS201, 每片主频500MHz, 片内RAM空间24Mbit
- 存储器: 32M×32bit。支持4通道全双工链路口, 链路口通讯速率可达16Gbps
- 高速总线: 2路1553B总线接口, 通讯速率为1Mbps、4Mbps
- LVDS接口: 3路LVDS接口, 传输速率150Mbps
- 硬件加速: 采用协处理单元进行硬件加速运算, 性能为250ms完成10亿次乘运算
- 图像匹配: 相关图像匹配算法, 协处理执行时间为137.15ms
- 对外接口: 10路开关量输出、12路开关量输入、2路AD输入、4路独立DA输出
- 重量: <5.5kg
- 先进导引头图像LVDS传输技术, 传输速率150MHz; FPGA重构技术, 可动态重构不同匹配算
- 重构时间不大于500ms; 高性能计算架构
- 高速总线技术, 提供更加灵活的主机接口方式
- 外形尺寸: 226mm×120mm×155mm
- 工作温度: -45℃— +65℃

应用领域

应用于车载、航空、船舶及工业控制领域。